

杭州士兰微电子股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字（2007）500号）的规定，将本公司截至2017年2月28日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可字（2013）688号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司、长江证券承销保荐有限公司采用定向增发的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票9,120万股，发行价为每股人民币4.80元，共计募集资金437,760,000.00元，坐扣承销和保荐费用14,000,000.00元后的募集资金为423,760,000.00元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2013年8月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,132,075.48元后，公司本次募集资金净额为422,627,924.52元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2013）247号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017年2月28日，本公司及成都士兰半导体制造有限公司（以下简称成都士兰公司）前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017年2月28日余额	备注
交通银行杭州东新支行	331066080018010092644	422,627,924.52	166,023.68	
交通银行杭州东新支行	331066080018010093065		60,786.86	
合 计		422,627,924.52	226,810.54	

前次募集资金投资项目中，成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目实施主体为本公司全资子公司成都士兰公司，实施方式为本公司利用募集资金按项目进度对全资子公司成都

士兰公司进行增资。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2017 年 2 月 28 日，由本公司全资子公司成都士兰公司实施的成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目已累计投入募集资金 28,022.89 万元，已完成承诺投资的 102.79%，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异-760.10 万元，是因为公司将累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额持续投入募投项目所致。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金项目对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

1. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

经 2014 年 4 月、6 月本公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十五次会议审议同意，本公司分别利用暂时闲置募集资金补充流动资金 2,400.00 万元、5,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。本公司已分别于 2014 年 4 月 14 日、2014 年 6 月 13 日自募集资金专户转入其他银行账户 2,400.00 万元、5,000.00 万元。以上利用暂时闲置募集资金补充流动资金的 7,400.00 万元，已分别于 2015 年 4 月 9 日、2015 年 6 月 10 日归还，并由本公司其他银行账户转入募集资金专户。

经 2015 年 5 月本公司第五届董事会第二十四次会议审议同意，成都士兰公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 1,500.00 万元，使用期限不超过 12 个月。成都士兰公司已于 2015 年 6 月 8 日自募集资金专户转入其他银行账户 1,500.00 万元。该部分资金已于 2016 年 3 月 13 日、2016 年 4 月 1 日分批归还，并由成都士兰公司其他银行账户转入募集资金专户。

经 2015 年 6 月本公司第五届董事会第二十五次会议审议同意，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 5,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。本公司已于 2015 年 7 月 20 日自募集资金专户转入其他银行账户 5,000.00 万元。该部分资金已于 2016 年 4 月 28 日归还，并由本公司其他银行账户转入募集资金专户。

2. 尚未使用的募集资金情况说明

本公司及成都士兰公司尚未使用的募集资金 226,810.54 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 7,827,815.15 元），尚未使用的募集资金占募集资金净额的

0.05%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。截至 2017 年 2 月 28 日，因前次募集资金投资项目所需资金未能完全募足，存在较大的资金缺口，为降低经营风险，公司分阶段实施募集资金投资项目，导致前次募集资金投资项目实现效益与承诺的达产后正常生产年度效益有较大差距。具体说明如下：

成都士兰公司一期工程项目原总投资额为 99,995.00 万元，该项目规划的产品及产能包括：实现新增照明用 LED 芯片 43.56 亿颗/年的产能；实现生产多种功率器件 5.4 亿只/年、多种功率模块 0.3 亿块/年的能力。

由于前次募集资金投资项目所需资金未能全部募足，实际拟投入成都士兰一期工程项目募集资金金额为 27,262.79 万元，较原拟用募集资金投入的规模（69,995.00 万元）存在较大的资金缺口。为降低经营风险，公司分阶段实施成都士兰公司一期工程项目。公司功率器件、功率模块生产流程包括外延片加工、芯片制造、封装测试等环节，2014 年 1 月和 2015 年 1 月，成都士兰公司外延片生产车间和功率模块封装车间相继投入生产，已分别形成年产外延片 62.4 万片、年封装功率器件 3.96 亿只和年封装 720 万块功率模块的生产能力。经公司 2017 年 3 月 4 日第六届董事会第五次会议审议通过，鉴于实际拟投入成都士兰一期工程项目募集资金与原拟用募集资金投入的资金规模之间存在较大的资金缺口等情况，根据公司总体业务规划和资金情况，拟将成都士兰一期工程项目总投资额由 99,995.00 万元调整为 70,000 万元，原先规划的 LED 芯片业务（拟以自有资金投入部分）将不再实施。本次投资额的调整不涉及募集资金改变。

截至 2017 年 2 月 28 日，成都士兰一期工程已累计投入资金 62,261 万元，其中：土地建筑物投入 26,486 万元、设备投入 26,954 万元、铺底流动资金投入 6,395 万元。由于产能分阶段释放，且实际产出规模相对较小，导致该项目在生产上量的第一年和第二年出现一定程度的亏损。截至 2017 年 2 月 28 日，该项目累计亏损 781.61 万元。今后，随着产能的进一步释放，该项目盈利情况将进一步改善。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 2 月 28 日

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：42,262.79						已累计使用募集资金总额：43,022.89				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
						2013 年：18,682.90				
变更用途的募集资金总额比例：无						2014 年：7,992.29				
						2015 年：6,886.22				
						2016 年：9,018.86				
						2017 年 1-2 月：442.62				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	成都士兰半导体制造有限公司一期工程	成都士兰半导体制造有限公司一期工程	69,995.00	27,262.79	28,022.89	69,995.00	27,262.79	28,022.89	-760.10	2016 年 12 月
2	补充流动资金	补充流动资金	18,000.00	15,000.00	15,000.00	18,000.00	15,000.00	15,000.00		2013 年 9 月

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 2 月 28 日

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2014 年	2015 年	2016 年度	2017 年 1-2 月		
1	成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目	97.00%、87.00% [注]	达产后正常生产年销售收入 140,418.00 万元、正常生产年所得税后利润 27,346 万元	2014 年该项目处于建设期和试生产阶段，产品销售收入 4,952.36 万元、销售毛利 296.86 万元、所得税后利润 -1,007.37 万元	2015 年该项目处于建设期和试生产阶段，产品销售收入 15,142.15 万元、销售毛利 1,327.21 万元、所得税后净利润 -477.12 万元	2016 年该项目处于建设期和试生产阶段。2016 年实现销售收入 19,732.27 万元，销售毛利 3,106.42 万元，所得税后净利润 696.39 万元。	2017 年 1-2 月实现销售收入 3,193.04 万元，销售毛利 361.84 万元，所得税后净利润 6.49 万元。	产品销售收入 43,019.82 万元、销售毛利 5,092.33 万元、所得税后利润 -781.61 万元	否

注：2016 年 1-12 月份成都士兰外延片生产车间产能利用率 97.00%，功率模块车间产能利用率 87.00%。